



株主通信

第21期上半期

自2022年4月1日 至2022年9月30日



TEDAT® 株式会社ジーダット <証券コード: 3841>

当冊子に関するお問合せ先

株式会社ジーダット 経営企画部

東京都中央区達1-1-12 HSB鐵砲洲 Tel: 03-6262-8400 (代)

E-mail: corporate.planning1@jedat.co.jp

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

液晶・OLED パネル向け高精度・高速容量抽出ソルバーを開発

2022年7月、ジーダットは、中国清華大学が設立したFDAソフトウェアベンダ EXCEEDA社の、最新フローティングランダムウオーク法抽出エンジンを導入した 「容量抽出ソルバー: SuperCap RX | を開発しました。

SuperCap RXは、解析サイズに制限なく、高精度を保ったまま処理速度を約10~ 100倍に向上させることが可能です。使用メモリサイズも約1/10に抑え、大規模な フラットパネル・タッチパネルの周辺配線から画素部を含んだ全体で容量を高速、 高精度に抽出できます。近年、大規模化・高精細化・任意形状化が進む国内外のパ ネルメーカーの設計効率化を飛躍的に推進します。

株式数及び株主数 (2022年9月30日現在)

発行可能株式総数 7,800,000 株 発行済株式総数 3,909,800 株 株主数 892 名

株主メモ

上場市場 東京証券取引所 スタンダード市場

4月1日から翌年3月31日まで 事業年度

定時株主総会 毎年6月 配当基準日 3月31日

株式の売買単位 100株

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 事務取扱場所

公告掲載方法

電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。

https://www.jedat.co.jp/

ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない

場合は日本経済新聞に掲載します。

会社概要 (2022年9月30日現在)

商号 株式会社ジーダット (Jedat Inc.)

所在地 〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲

代表者 代表取締役社長 松尾 和利

営業開始 2004年2月2日 資本金 762,524,260 円

事業内容 電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のための

ソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2023年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当第2四半期累計期間における売上高は、前年同四半期比7.6%増加し9億75百万円、営業利益は、前年同四半期比48.9%増加して1億35百万円となりました。経常利益は、助成金収入に加えて円安による為替差益等を計上したことにより1億79百万円(前年同四半期比81.2%増)となり、四半期純利益は、外国税額控除を適用したこと等により1億53百万円(前年同四半期比613.4%増)となりました。

当第2四半期累計期間における当社の主要顧客である電子部品業界は、半導体関連の特定分野において供給過多の兆候が散見されるようになってきており、一部の分野における半導体の供給不足や製造装置関連の好況感は残るものの、全体としては景気の減速感が鮮明となりつつあります。

このような状況の中当社は、6月に当社の主力製品:SX-Meisterの最新バージョンをリリースし、アナログ設計自動化機能等の機能拡張を行いました。そして7月には液晶パネルや有機ELパネル等のFPD(Flat Panel Display)設計向けに最新のアルゴリズムを導入した高精度・高速解析ツールを開発しました。製品の販売促進活動においては、パワー半導体やアナログ半導体分野に加えて、素材関連や製造装置関連等に販売を行いました。またデバイス設計受託では、国内の底堅い設計委託需要を背景に、売上は堅調に推移しました。さらに海外市場向けの販促活動では、旺盛な投資が継続中の環境下、順調に売上を伸ばすことができました。

当下半期におきましても、引き続き主力製品等の開発、機能強化の活



動を行ってまいります。新規リリース製品の販促・情報発信活動を促進し、パワーデバイス設計向けツールの販促活動を強化、大学・企業とのオープン・イノベーションも継続してまいります。株主の皆様におかれましては引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。

代表取纬役社長

松尾和利

第2四半期累計期間 売上高 (単位:百万円)

		2022年 3月期	2023年3月期		
		実績	期初計画	実績	前年同期比
事業別売上高	製品	522	582	556	+ 6.4%
	サービス	197	213	208	+ 5.6%
	ソリューション	185	223	210	+ 13.3%
市場別売上高	半導体市場	654	720	696	+ 6.3%
	FPD市場	251	297	278	+ 11.1%
製品区分別 売上高	自社開発製品	713	791	794	+ 11.3%
	代理販売製品	192	227	181	△ 5.7%
売上高合計		906	1,018	975	+ 7.6%

財務ハイライト (単位:百万円)







